

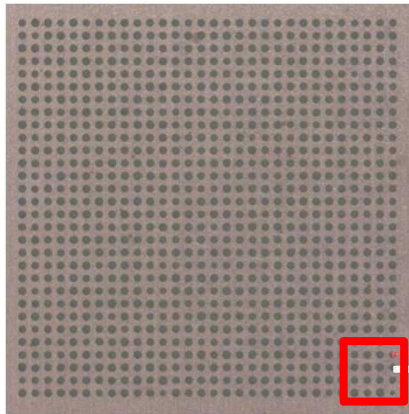
鉛フリーソルダペースト

超微小吐出対応

PF305-5091V0

合金組成：Sn-3.0Ag-0.5Cu

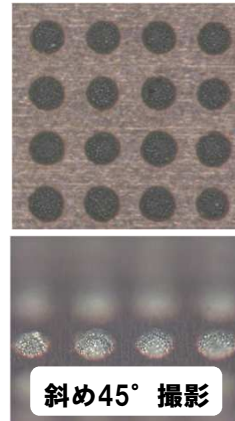
◆ ディスペンスで塗布径100 μ mを実現



安定した連続吐出性



赤枠内の拡大



塗布形状が安定

<吐出条件>

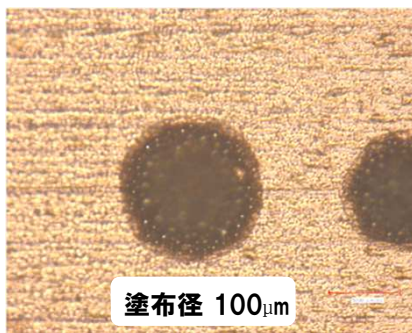
吐出装置：Twin-air（エンジニアリングシステム株式会社製）

使用基板：ガラスエポキシ（FR-4）製銅張積層板（パターン無し）

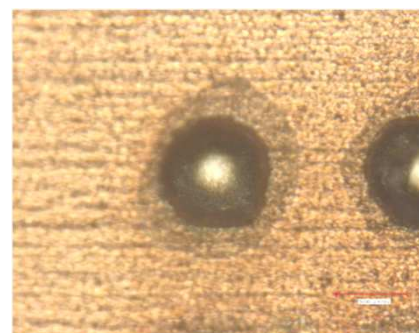
使用ノズル： $\Phi=70\mu\text{m}$ セラミックノズル 塗布径：100 μm 吐出間隔：100 μm

試験協力：エンジニアリングシステム株式会社

◆ 良好な溶融性



リフロー前



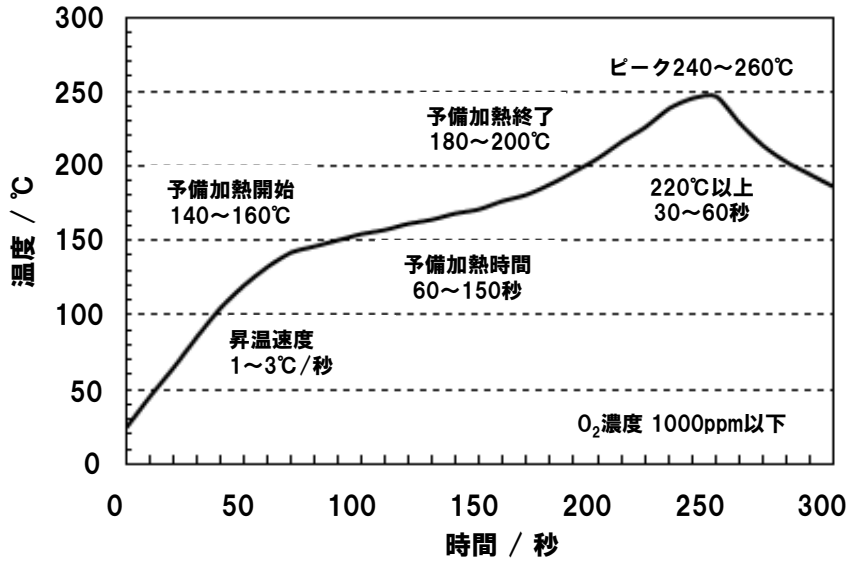
リフロー後

<リフロー条件>

予備加熱：150~190 $^{\circ}\text{C}$ 90秒、ピーク温度：245 $^{\circ}\text{C}$ 、220 $^{\circ}\text{C}$ 以上：40秒

O₂濃度：1000ppm（3000ppmでもリフロー可）

◆ 推奨温度プロファイル



一般的な
SAC305用の
プロファイルで
リフロー可能

◆ 一般特性

		代表特性	試験方法
合金組成 ¹⁾		Sn-3.0Ag-0.5Cu	—
粒径 ²⁾		IPC Type.7 (2~12μm)	—
フラックス含有量		16 wt%	—
ハライド含有量		0.04%	JIS Z 3197
フラックスタイプ		ROL1	IPC J-STD-004
銅板腐食試験		合格	JIS Z 3284
絶縁抵抗試験	40°C 90%RH 168時間後	1.0×10 ¹¹ Ω以上	JIS Z 3284
	85°C 85%RH 168時間後	1.0×10 ⁸ Ω以上	
粘着試験 (粘着力100gf以上保持時間)		8時間	JIS Z 3284
流動特性	粘度	100 Pa・s	JIS Z 3284
	Ti値	0.40	

*上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

1) その他の合金につきましては、営業スタッフまでご相談下さい。

2) Type.5及びType.6も対応可能です。

MEMO